



출력 일자 : 2008/10/23

발송번호 : 9-5-2004-014223787

발송일자 : 2004.04.12

제출기일 : 2004.06.12

심사관	담당관	국 장	보 고
			

특허청 의견제출통지서

출원인 **명칭** 주식회사 파이컴 외 1 명 (출원인코드: 120000063927)

주소 서울 금천구 가산동 60-29번지

대리인 **성명** 김인한

주소 서울특별시 서초구 서초동 1695-4 대림빌딩502호 웰쳐국제특허법률사무
 소

출원번호 10-2003-0016635

발명의 명칭 프로브 포지셔닝 및 본딩시스템 및 그 방법

이 출원에 대한 심사결과 아래와 같은 거절이유가 있어 특허법 제63조의 규정에 의하여 이를 통지하
오니 의견이 있거나 보정이 필요할 경우에는 상기 제출기일까지 의견서[특허법시행규칙 별지 제25호
의2서식] 또는/및 보정서[특허법시행규칙 별지 제5호서식]를 제출하여 주시기 바랍니다.(상기 제출기
일에 대하여 매회 1월 단위로 연장을 신청할 수 있으며, 이 신청에 대하여 별도의 기간연장승인통지
는 하지 않습니다.)

[이 유]

1. 이 출원의 특허청구범위 제1항 및 제4항 내지 제6항에 기재된 발명은 그 출원전에 이 발명이
속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 아래에 지적한 것에 의하여 용이하게 발명할 수
있는 것이므로 특허법 제29조제2항의 규정에 의하여 특허를 받을 수 없습니다.

[아래]

본원발명은 레이저에 의한 본딩과 핀셋에 의한 프로브 고정장치부가 특징인 프로브 포지셔닝 및 본
딩시스템으로 인정되나, 등록실용공보 제0004245호(1989.06.26. 이하 인용발명1이라 합니다)에서 반
도체 칩 자동본딩 장치 기술이 개시되어 있어 본원발명 제1항의 작업대, 지지대, 마이크로스코프, 고
정장치부, 스테이지 및 로딩장치부와 유사하고, 일본공개특허공보 소60-247487호(1985.12.07. 이하
인용발명2라 합니다)에서 레이저에 의한 와이어 본딩장치 기술이 개시되어 있어 본원발명의 레이저와
프로브 고정장치부와 유사하고, 미국특허공보 05811751호(1998.09.22. 이하 인용발명3이라 합니다)에
서는 프로브 스테이션과 레이저 절단기술이 개시되어 있어, 본원발명의 마이크로스코프, 레이저, 스
테이지부와 유사합니다.

따라서 본원발명의 청구범위 제1항 및 제4항 내지 제6항에 기재된 발명은 인용발명1, 인용발명2 및
인용발명3의 기술들의 결합으로부터 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하
게 발명할 수 있습니다.

2. 이 출원은 특허청구범위의 기재가 아래에 지적한 바와 같이 불비하여 특허법 제42조제5항 및 동법
시행령 제5조제5항의 규정에 의한 요건을 충족하지 못하므로 특허를 받을 수 없습니다.

본원발명의 청구범위 제5항은 20이상의 항을 인용하는 청구항이나 항의 번호를 택일적으로 기재하지
않아 특허법 제42조제5항 및 동법시행령 제5조제5항의 규정에 의하여 특허를 받을 수 없습니다.

출력 일자 : 2008/10/23

[첨 부]

- 첨부1 등록실용공보 0004245호(1989.06.26) 1부.
첨부2 일본공개특허공보 소60-247487호(1985.12.07) 1부.
첨부3 미국특허공보 05811751호(1998.09.22) 1부. 끝.

2004.04.12

특허청 전기전자심사국

반도체심사담당관실

심사관 맹성재



심사관 김준학



<<안내>>

문의사항이 있으시면 ☎ 042)481-5727 로 문의하시기 바랍니다.